



美韩存储战略深度绑定，玻璃基板封装 加速破局

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年07月27日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

美韩AI战略深度绑定，SK海力士/三星锁定超9000亿美元存储芯片大单

7月24日，韩国总统李在明在旧金山发布《旧金山AI宣言》，正式推动韩国与美国科技巨头在AI领域的国家级战略绑定。据路透社报道，三星电子与SK海力士将与美国大型科技公司达成总价值高达9500亿美元的存储芯片供应合作。其中，SK海力士向英伟达提供价值7500亿美元的长期存储芯片，三星电子向博通提供价值2000亿美元的芯片。

与此同时，英伟达与SK集团进一步公布了一项超过5000亿美元的AI基础设施计划，涵盖大型AI数据中心建设及下一代HBM开发。SK电讯将在韩国建设总容量达2吉瓦的AI数据中心，首个项目采用英伟达Vera Rubin平台和SK海力士HBM4内存，预计2027年正式投入运营。SK海力士计划到2030年将其晶圆产能扩大一倍，以进一步提升HBM供应能力。三星与博通还签署战略合作谅解备忘录，围绕存储芯片和晶圆代工展开合作，三星将为博通下一代AI加速器提供先进存储方案，并围绕2纳米及以下先进制程共同开发产品。

英特尔联合蓝思科技布局玻璃基板封装，国内面板/精密制造龙头加速切入半导体封装赛道

7月25日，英特尔公司与蓝思科技宣布达成战略合作，共同开发先进半导体封装新技术，聚焦玻璃基板封装解决方案。双方将发挥各自在先进半导体封装、精密制造、玻璃基板研发及工艺创新方面的优势，以支持AI、数据中心和特定计算应用日益增长的需求。

英特尔首席执行官陈立武表示，随着AI系统持续推动性能、规模和效率边界的突破，先进封装正成为半导体创新的关键驱动力。蓝思科技创始人周群飞表示，蓝思科技在玻璃材料、高精度激光加工和先进制造方面具备专业能力，此次合作将加快下一代计算解决方案及AI基础设施的发展进程。双方还将在AI PC组件、数据中心高可靠性结构与散热解决方案、AI机器人及边缘计算硬件平台等领域探索潜在合作。

值得关注的是，今年5月，京东方与康宁公司亦签署三年合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连等方向开展合作。短短两月内，国内企业在玻璃基板这一全新赛道迎来两起重重量级国际合作，反映出产业界对玻璃基板在高频、高密度、高可靠性场景下应用潜力的高度共识。

建议关注：惠科股份、蓝思科技、京东方。

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

公司代码	名称	2026-07-26 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
000725.SZ	京东方A	5.79	0.16	0.20	0.32	36.19	28.95	18.09	买入
001399.SZ	惠科股份	25.10	0.58	0.63	1.31	43.28	39.84	19.16	买入
300433.SZ	蓝思科技	37.32	0.76	0.92	1.30	49.11	40.57	28.71	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

7月20日-7月24日当周，海外龙头总体呈震荡分化态势。其中，美光科技领涨，涨幅为8.48%，意法半导体领跌，跌幅为16.95%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

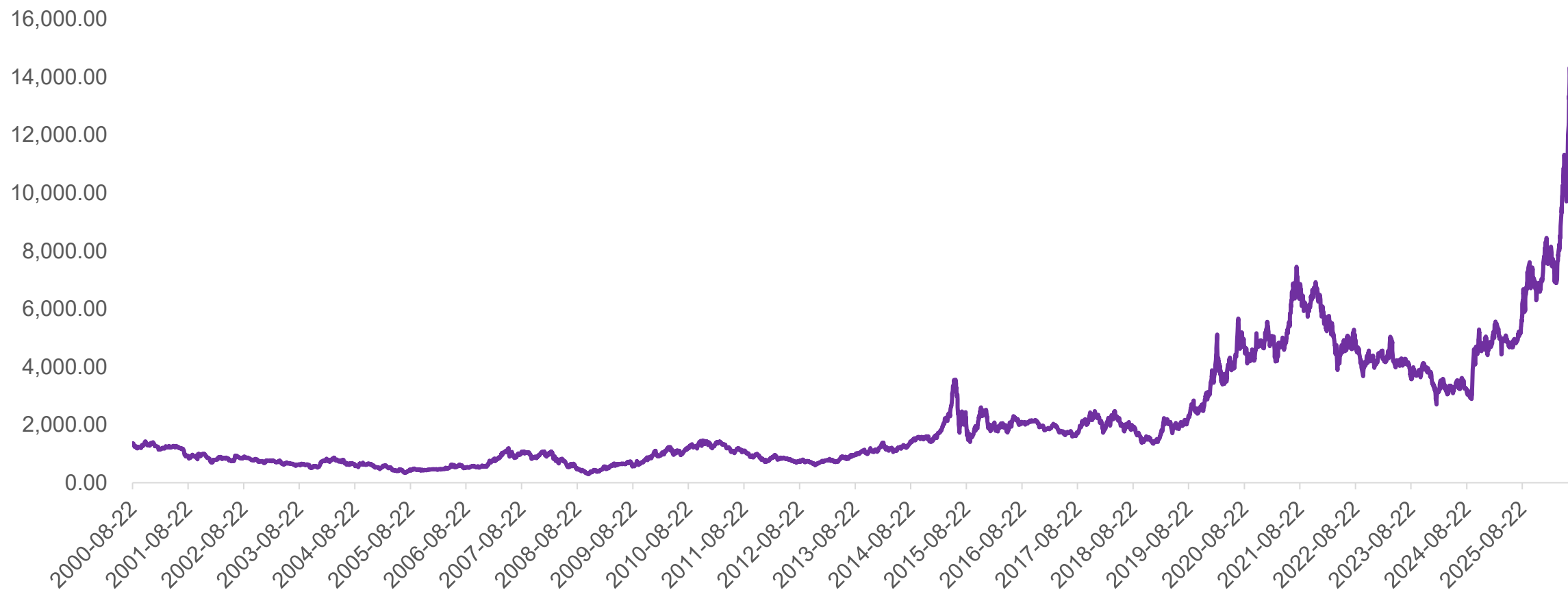
	证券代码	证券简称	国家/地区	市值（亿元）	PE (LYR)	PB (MRQ)	周涨跌幅（%）
处理器	INTC.O	英特尔 (INTEL)	美国	4655.70	-1743.71	5.32	-2.86
	QCOM.O	高通 (QUALCOMM)	美国	1759.86	31.76	6.45	-2.80
	AMD.O	超威半导体 (AMD)	美国	8510.92	196.33	13.20	5.28
	NVDA.O	英伟达 (NVIDIA)	美国	50055.28	41.69	25.61	1.99
存储	MU.O	美光科技 (MICRON TECHNOLOGY)	美国	10401.15	121.81	10.33	8.48
模拟	TXN.O	德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS)	美国	2552.57	51.33	14.18	-1.56
	ADI.O	亚德诺 (ANALOG)	美国	1811.28	79.89	5.37	-0.93
	AVGO.O	博通 (BROADCOM)	美国	18170.15	78.57	20.72	2.99
	NXPI.O	恩智浦半导体 (NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	679.75	33.63	6.22	1.02
射频	SWKS.O	思佳讯 (SKYWORKS)	美国	90.56	18.98	1.57	1.45
	QRVO.O	QORVO	美国	76.32	22.51	2.28	1.18
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	460.02	277.12	2.61	-16.95
	ON.O	安森美半导体 (ON SEMICONDUCTOR)	美国	340.21	281.17	4.66	-0.64
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	841.14	82.87	4.83	1.18
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	5127.29	24.10	2.78	-2.24
半导体设备	AMAT.O	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	4257.61	60.84	17.81	1.24
	LRCX.O	拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	3816.87	71.23	36.06	-2.58
	KLAC.O	科天半导体 (KLA)	美国	2749.97	67.71	47.17	-1.05
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	6919.96	61.46	27.92	0.54
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	4924.57	67.35	5.27	-16.94
晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	677863.38	35.90	9.47	2.62
	GFS.O	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	293.72	33.19	2.51	-6.87
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	1447.76	85.47	3.54	2.71
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	820.39	63.57	7.51	-4.09
分销	ARW.N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	108.54	19.00	1.61	2.74
	AVT.O	安富利 (AVNET)	美国	73.35	30.53	1.48	4.40

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

7月20日-7月24日当周，申万半导体指数整体呈现反弹回升的态势。7月24日，申万半导体指数为10455.56，周涨幅为2.23%

图表3：近5年申万半导体指数

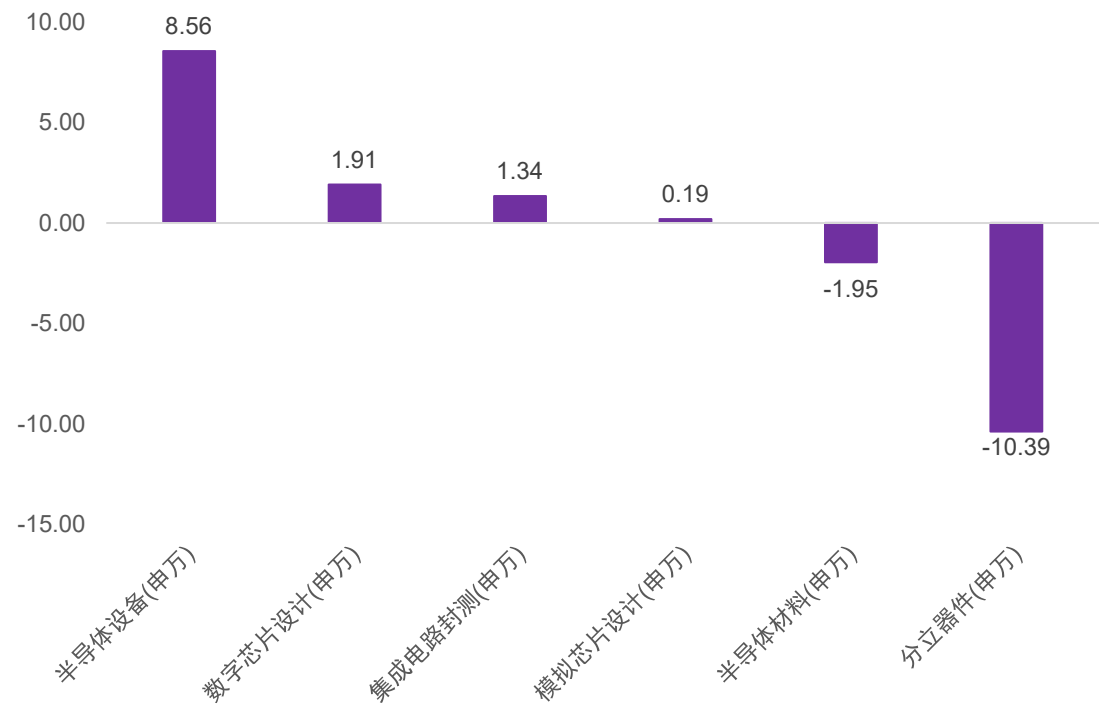


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，7月20日-7月24日当周，半导体细分板块涨跌互现。其中，半导体设备板块涨幅最大，达到8.56%；分立器件板块跌幅最大，达到10.39%。估值方面，半导体材料、分立器件、模拟芯片设计板块估值水平位列前三。

图表4：7月20日-7月24日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：7月24日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：
 消费电子板块主力净流入2.80亿元，主力净流入率为0.07%，在9个二级子行业中排第1名；航天装备II板块主力净流出7.87亿元，主力净流入率为-2.16%，在9个子行业中排第9名。

图表6：7月20日-7月24日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW消费电子	14,027,030.31	13,999,059.51	27,970.80	0.07	-1
SW军工电子II	4,081,013.22	4,084,935.09	-3,921.87	-0.03	4
SW电子化学品II	6,653,731.58	6,697,234.71	-43,503.12	-0.21	-2
SW半导体	94,055,125.72	94,561,694.26	-506,568.54	-0.23	1
SW计算机设备	8,169,288.42	8,281,555.31	-112,266.88	-0.49	-3
SW其他电子II	3,044,088.13	3,110,361.88	-66,273.76	-0.67	4
SW其他电源设备II	2,393,326.21	2,461,877.09	-68,550.88	-0.86	-1
SW通信设备	45,485,264.21	47,114,348.04	-1,629,083.83	-1.72	-3
SW航天装备II	765,121.23	843,810.49	-78,689.26	-2.16	-5

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

7月20日-7月24日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：盛科通信-U，华勤技术，联创电子，全志科技，普冉股份，芯基微装，翱捷科技-U，晶晨股份，通富微电，芯朋微，周涨幅分别为：25.25%，22.90%，21.51%，16.55%，16.21%，13.62%，12.13%，12.13%，12.11%，12.11%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值（亿元）	EPS			PE			PB	周涨跌幅（%）
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E		
688620. SH	盛科通信-U	1602. 20	-0. 37	0. 13	0. 32	-1068. 53	2967. 03	1232. 46	71. 79	25. 25
603296. SH	华勤技术	1309. 83	3. 99	3. 94	4. 31	31. 91	32. 70	20. 04	4. 46	22. 90
002036. SZ	联创电子	76. 46	-0. 96	-	-	-7. 13	-	-	7. 92	21. 51
300458. SZ	全志科技	407. 29	0. 32	0. 47	0. 58	155. 38	87. 97	70. 83	12. 78	16. 55
688766. SH	普冉股份	376. 41	2. 77	3. 39	3. 96	128. 73	105. 14	90. 05	15. 57	16. 21
688630. SH	芯基微装	574. 55	2. 20	3. 73	4. 88	198. 17	116. 78	89. 35	10. 92	13. 62
688220. SH	翱捷科技-U	467. 53	-0. 93	0. 41	0. 75	-119. 79	275. 02	149. 26	8. 59	12. 13
688099. SH	晶晨股份	414. 85	2. 07	3. 49	4. 49	47. 66	28. 41	21. 80	5. 51	12. 13
002156. SZ	通富微电	1163. 09	0. 80	0. 93	1. 12	84. 45	82. 84	68. 54	7. 49	12. 11
688478. SH	芯朋微	89. 64	1. 42	1. 57	2. 01	48. 34	43. 01	33. 72	3. 29	12. 11

资料来源：wind，华鑫证券研究

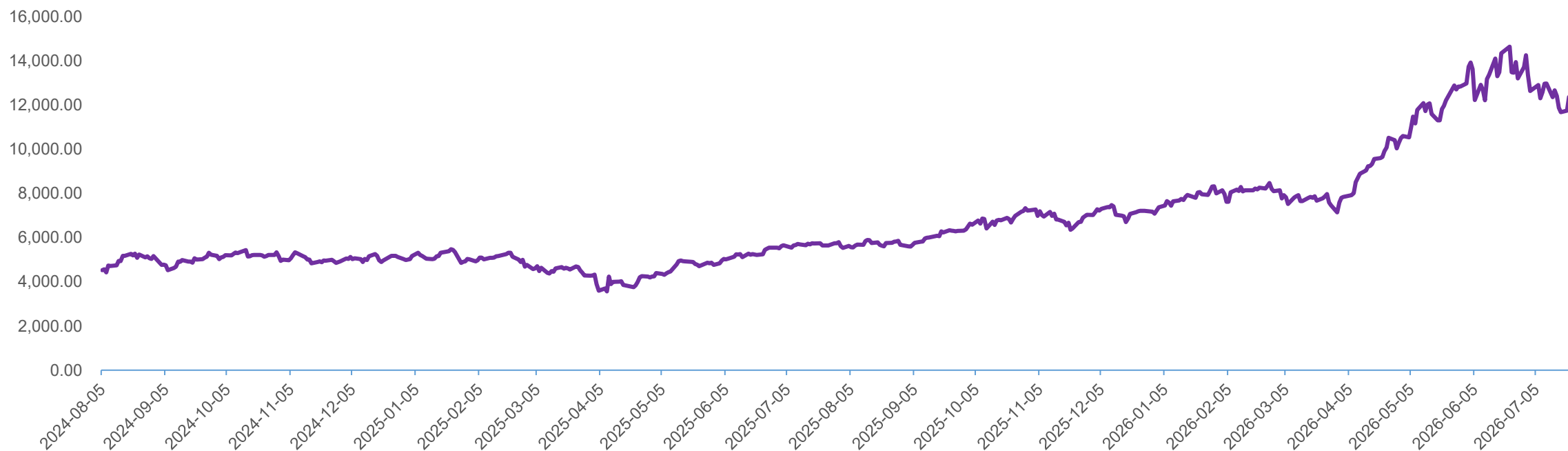
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，7月20日-7月24日当周，费城半导体指数总体呈现企稳回升的态势，在2026年7月24日出现下跌至11818.89，近两周整体呈现震荡下跌的态势。更长时间维度上来看，2023年年底开始持续上涨。2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，二季度三季度均呈现震荡上行的态势。2026年七月以来，指数在6月达到阶段高点后持续回落，7月中旬触底后呈现震荡筑底的态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

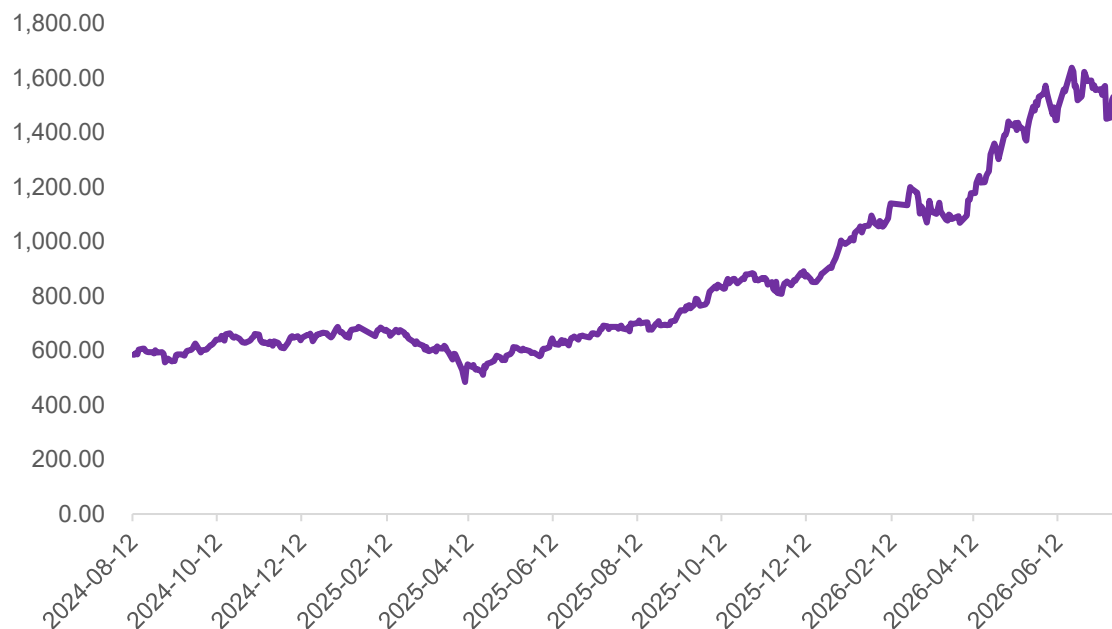


资料来源：wind，华鑫证券研究

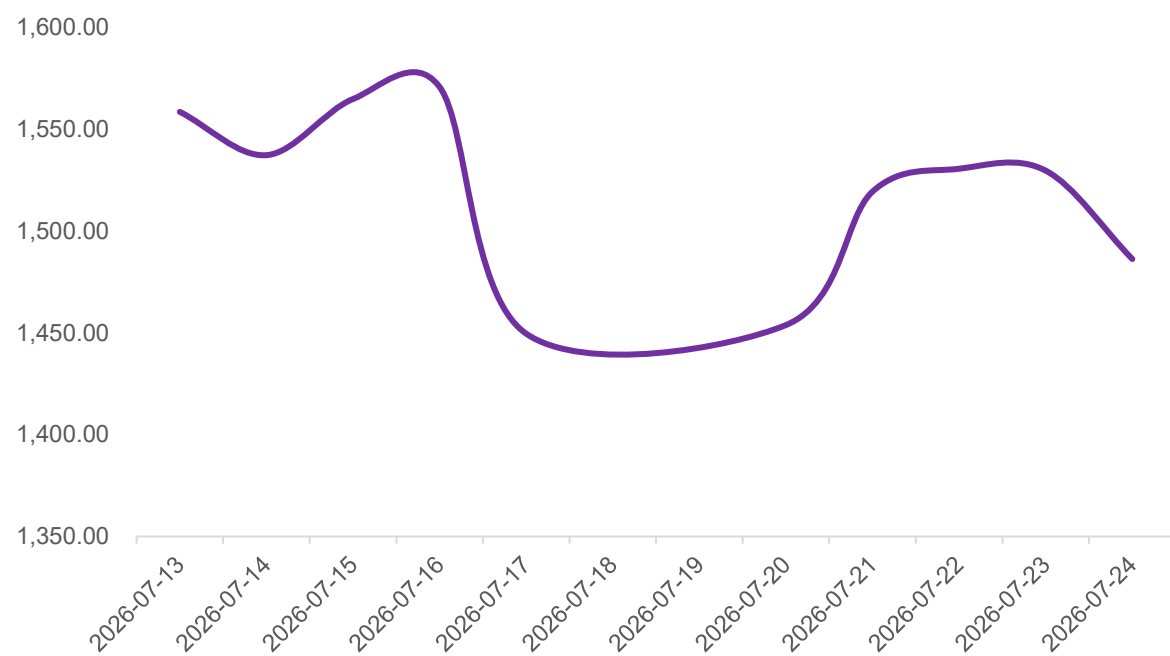
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，7月13日-7月24日两周，台湾半导体行业指数呈现震荡下降态势。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。2026年七月以来，指数在月初达到阶段高点后持续回落，呈现震荡下跌态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



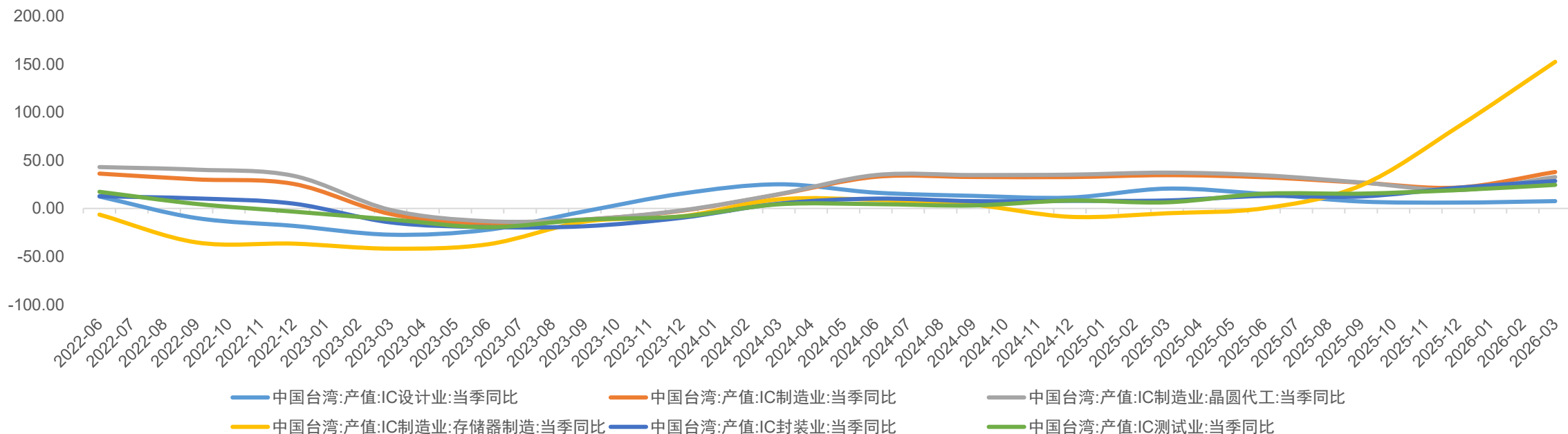
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致IC设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。2026年一季度，中国台湾IC各板块产值同比增速全面上行。在AI算力需求持续旺盛及存储器行业周期复苏的推动下，2026年Q1中国台湾IC产业景气度显著上行。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

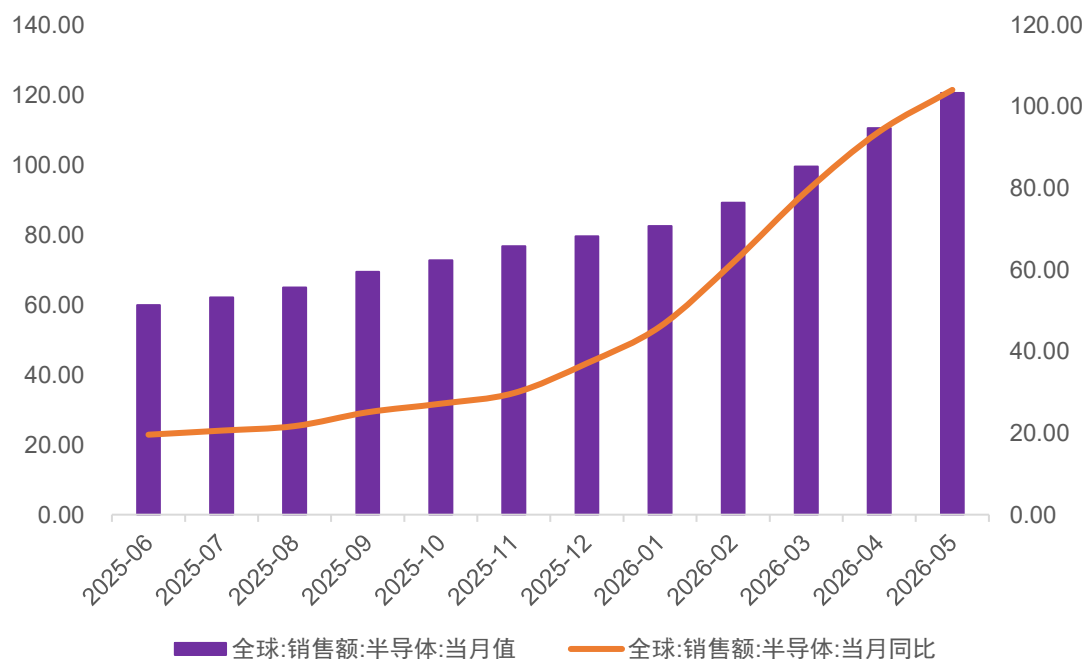


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年5月，全球半导体当月销售额为1206.10亿美元，同比增长104.10%。其中，中国销售额为319.70亿美元，环比增长10.70%，占比达26.51%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



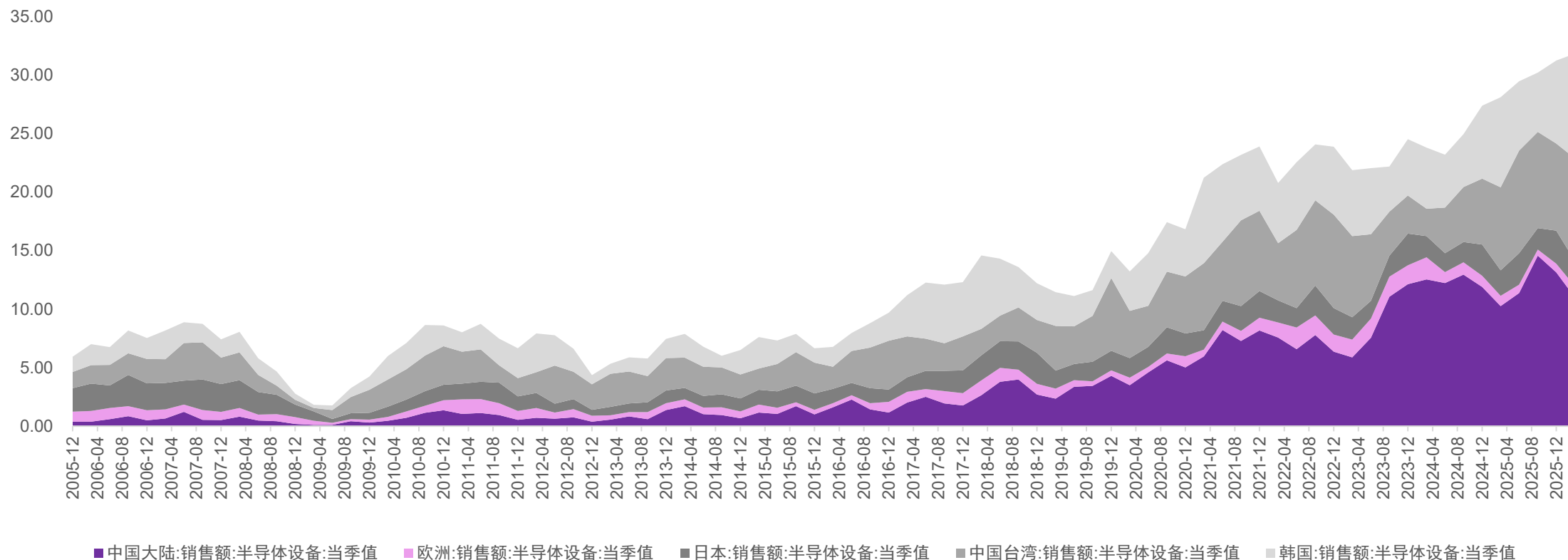
图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2026年一季度，中国大陆半导体设备销售额达到109.9亿美元，同比增长7.12%，环比下降16.30%，占全球主要地区比重达34.56%。

图表14：全球半导体设备销售额（十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。2026年1-2月进口数量阶段性回落，3月起持续回升，6月达7583台，4-5月连续两月维持在较高水平，显示国内晶圆厂扩产需求旺盛。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

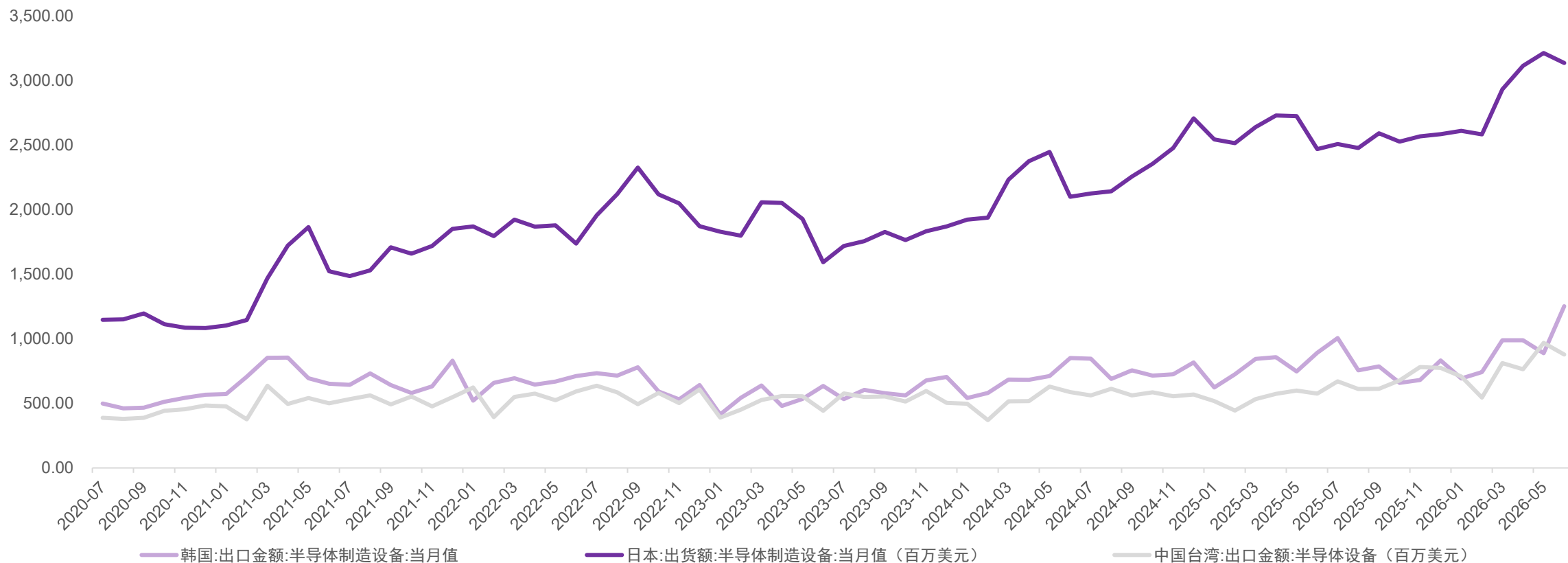


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。2026年以来，日本半导体设备出口额持续攀升并创阶段新高；韩国出口额近期大幅回升，中国台湾出口额高位有所回落。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



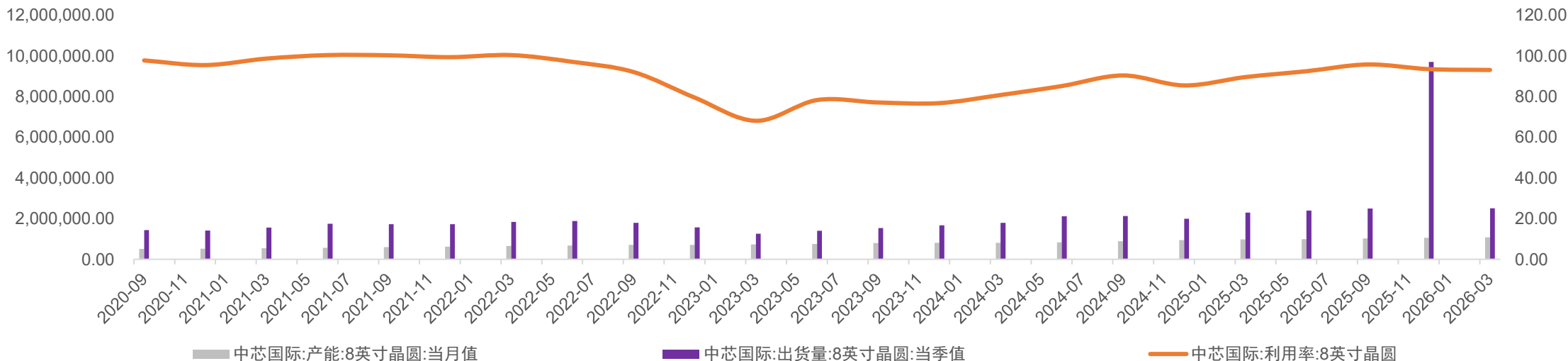
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020 -2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至68.1%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第三季度已恢复至95.8%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第三季度达到近250万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。2026年一季度8英寸晶圆出货量达到约250.9万片，维持历史高位。整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）



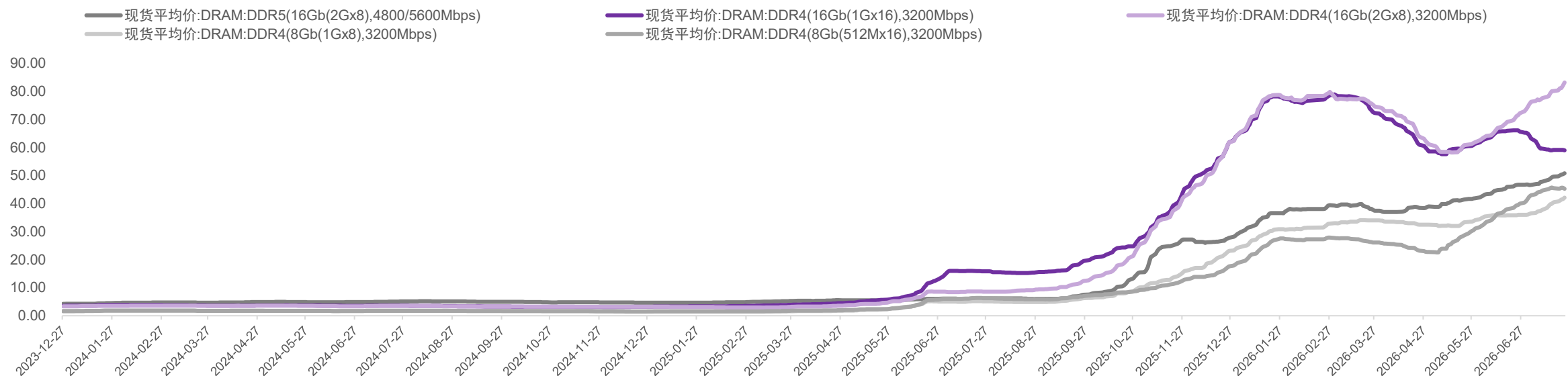
资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年3月以来小幅上涨，4月后价格略有下滑，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年2月23日价格为17.95美元。

DRAM方面：DDR5(16Gb,4800/5600Mbps)现货均价自2025年以来呈现大幅上涨态势，2026年3月初约39.67美元，此后延续上涨，截至7月24日价格已达50.83美元。DDR4各规格产品分化运行，16Gb(2Gx8)3200Mbps现货价由6月18日的69.13美元进一步升至7月24日的83.25美元，16Gb(1Gx16)3200Mbps现货价由6月18日的66.00美元回落至7月24日的59.00美元。整体来看，在AI需求拉动及供给端产能转向HBM的背景下，DRAM价格整体延续分化上涨态势，主流规格持续走高，部分规格高位震荡回调。

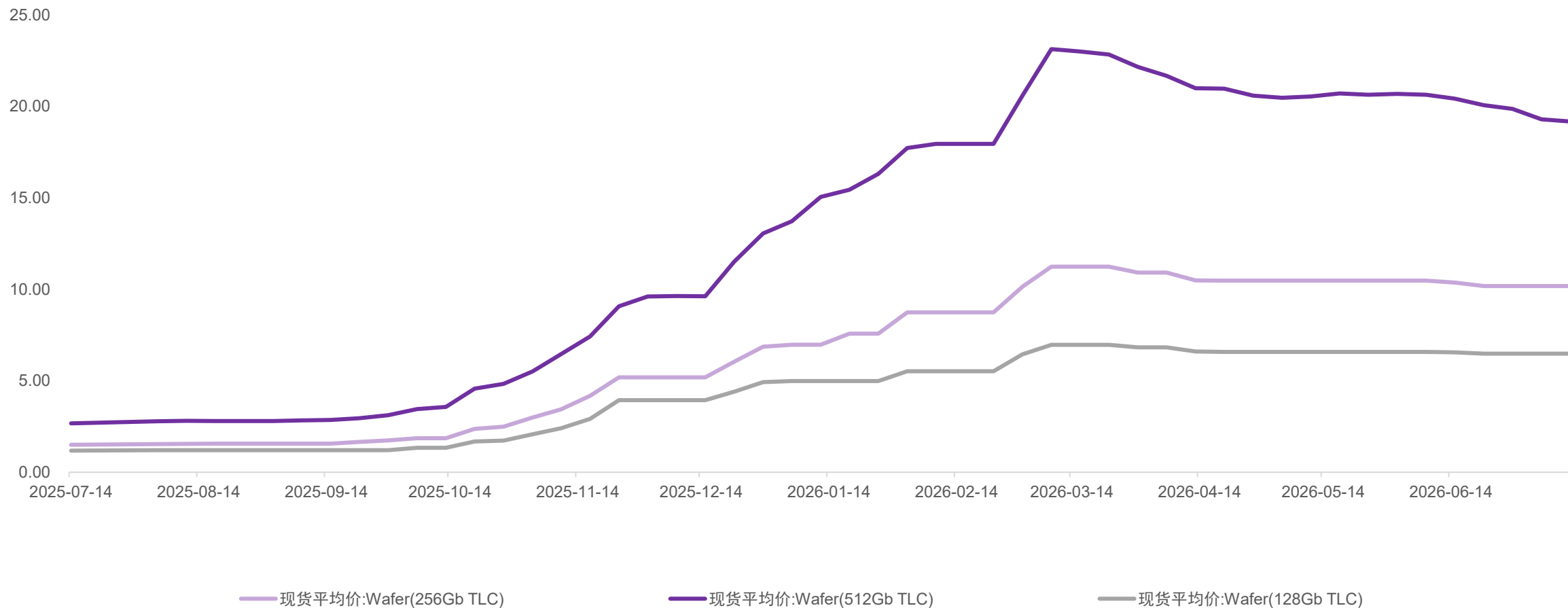
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

胜科纳米与牛津仪器签署协议 围绕iWUDI™共探半导体材料表征智能化

近日，胜科纳米与牛津仪器（Oxford Instruments）正式签署联合实验室框架协议，双方将围绕胜科纳米自主研发的iWUDI™智能闭环系统，在半导体材料表征及应用领域展开深度合作。

在半导体材料表征领域，一个长期存在的行业痛点是：高精度表征数据分散于不同设备、软件和报告之间，难以与工艺、材料及产品信息有效关联，形成典型的“信息孤岛”。胜科纳米与牛津仪器的此次合作，正是为了打破这一局面。

牛津仪器在电镜微区分析领域拥有行业领先的能谱（EDS）、电子背散射衍射（EBSD）、纳米压痕、拉曼、原子力等技术，能够精准获取材料的成分、晶体取向与应变分布等关键微观结构数据，加速先进封装、半导体材料与器件等领域的研发和失效分析等突破。而胜科纳米自主研发的iWUDI™（Wintech User Digital Intelligence）则是一套AI+CIM原生智能闭环系统，整合了流程、设备、数据、模型与服务，能够提供从在线下单、AI辅助分析到报告交付与数据沉淀的全链路智能服务，将分散的检测数据转化为可积累、可复用的工程知识。

双方的合作关系清晰互补：牛津仪器提供业界顶尖的材料表征数据输入，实现纳米级分辨率、稳定高效的显微分析表征，iWUDI™则为这些数据赋予智能分析与知识沉淀能力，使每一次分析都能转化为可复用的工程经验，真正打通从“数据”到“知识”的闭环。

TCL科技超93亿收购广州华星半导体45%股权重组过审

7月24日晚间，TCL科技发布公告称，公司拟斥资93.25亿元收购广东恒健、广州城发星光、科学城投资三家国资合计持有的广州华星半导体45%股权。该重组事项已顺利通过深交所并购重组审核，待证监会注册批复后即可落地。交易完成后，TCL科技将实现对广州TCL华星t9产线运营主体的100%全资控股。

本次标的资产总交易作价93.25亿元，采用发行股份+现金五五分摊的支付方案，股份对价、现金对价均为46.62亿元。向三家国资发行股份总量11.46亿股，除权后发行价4.07元/股，发行后新增股份占总股本5.22%。交易对手取得股份承诺锁定12个月。

与最初方案相比，TCL科技作出关键调整，全面取消配套定增计划，全部46.62亿元现金对价依靠自有资金自筹资金解决。公司表示，此举规避股权进一步稀释，也侧面体现现金流与经营基本面持续向好。

广州华星半导体对应业内知名t9高世代面板产线，总投资350亿元，是全球少数量产氧化物背板的专业化产线，主打笔记本、高端显示器、平板、车载显示等高附加值中尺寸面板，采用自研4mask Oxide、HFS高透光技术，切割效率领先行业，同时预留Micro LED、印刷OLED升级空间。

根据评估数据显示，以2025年12月31日为基准日，广州华星净资产账面价值194.24亿元，资产基础法评估值207.22亿元，评估增值率仅6.68%，定价公允合理。从2025年备考财务数据来看，本次收购不存在即期收益摊薄效应，交易完成后，TCL归母净利润由45.17亿元增至50.38亿元，增幅11.53%；基本每股收益从0.2333元提升至0.2459元，涨幅5.40%。公司资产负债率由64.23%上升1.25个百分点至65.48%，现金支付将阶段性占用流动资金。

中船特气(688146.SH)：半年报业绩超预期

7月23日晚公司披露的2026年半年报业绩。上半年公司实现营业收入19.04亿元，同比增长83.13%；归母净利润3.48亿元，同比增长95.63%；扣非归母净利润3.26亿元，同比增长117.08%，二季度单季归母净利润同比增长170.51%。该业绩超出市场普遍预期，扣非利润增速显著高于营收，体现产品结构优化、高毛利产品放量带动盈利效率持续提升，AI算力拉动先进芯片需求带来业绩逐季走强，直接催化估值修复。

中船特气属于半导体材料领域电子特气细分赛道，核心主业为电子特种气体及三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，拥有全球最大超高纯六氟化钨产能生产基地，截至报告期末六氟化钨年产能达2000吨，产品多年来稳定供应台积电、美光、海力士、英飞凌、铠侠、格罗方德、中芯国际、长江存储、长鑫集团、华虹集团、华润集团等国内外集成电路知名客户，为六氟化钨全球主流供应商、国内电子特气收入规模排名第一的龙头企业。

玻璃封装产业化加速

过去几十年，半导体产业衡量技术进步，主要看晶体管能否继续缩小。但在AI芯片时代，越来越多的性能提升并不是在一颗芯片内部完成，而是来自GPU、CPU、HBM、网络芯片、I/O Die以及各种Chiplet在同一封装中的协同。先进封装已经从芯片制造完成之后的“后段工序”，变成直接决定算力密度、内存带宽、功耗和系统成本的关键环节。而玻璃受到关注，首先不是因为它是一种新材料，而是因为AI芯片的封装尺寸正在迅速接近传统材料和制造体系的极限。

台积电已经将CoWoS从早期约一个光罩尺寸不断扩大。2026年，台积电开始生产5.5倍光罩尺寸的CoWoS，并计划在2028年推出14倍光罩尺寸版本，理论上可集成约十颗大型计算芯片和20组HBM，2029年还将继续向更大尺寸推进。

英特尔将传统有机材料的主要限制概括为收缩、翘曲、供电和互连密度。其公布的玻璃基板技术目标，是将封装设计规则提升一个数量级，支持更高密度的互连和更大规模的Chiplet组合。英特尔认为，玻璃更高的刚度、平坦度和尺寸稳定性，可以使封装继续向更大面积、更细线路和更高I/O密度演进。

三星电机、AGC等厂商所强调的热性能，主要是指玻璃具有较低或可调的热膨胀系数，在温度变化过程中尺寸更稳定，从而减少载板翘曲和层间错位；它解决的是热机械稳定性问题，而不是直接替代散热器、冷板或热界面材料。

英伟达预付100亿，锁定先进封装

英伟达公司与Amkor Technology Inc.签署了一项价值15亿美元（约100亿人民币）的协议，以帮助加强该公司的芯片封装设施，这是该公司在美国扩大半导体业务的更广泛举措的一部分。

根据Amkor Technology周四发布的公告，该协议涉及英伟达的预付款，将帮助Amkor提升其在亚利桑那州的生产能力。公告称，Amkor Technology与英伟达达成战略合作，旨在拓展先进封装技术并进行下一代人工智能测试。消息公布后，Amkor股价在尾盘交易中飙升约15%。

两家公司表示，此次合作将重点关注人工智能芯片封装和测试技术。封装是半导体制造过程中至关重要的最后一步，它将芯片放入外壳中，使其能够与其他组件连接。此外，位于亚利桑那州的这家工厂将扩大安靠在亚洲的产能，从而打造“地域多元化且更具韧性的全球供应链”。安靠总部位于亚利桑那州坦佩市，是芯片封装和测试服务领域的领先供应商。

这项交易是全球市值最高的公司英伟达一系列合作协议的一部分，该公司正利用其资源拓展人工智能计算产业。英伟达是人工智能加速器领域的领军企业，其生产的芯片备受推崇，用于开发和运行人工智能软件。

由于行业正努力满足激增的需求，用于加速芯片等组件的先进封装已成为供应瓶颈。这些产品越来越需要使用特殊材料和技术，才能与数据中心的高端计算机连接。

总投资7亿元，两大半导体装备项目签约落户佛山

据佛山政府网消息，7月22日上午，蓝河科技（绍兴）有限公司与深圳市原速科技有限公司同日签约落户南海，两大半导体装备领域“隐形冠军”同步落子，为佛山半导体产业链强链补链再添硬核支撑。两大项目的集中签约，标志着南海在半导体装备领域的产业集聚效应加速显现，为打造半导体及新型显示装备产业高地注入了强劲动能。

蓝河科技落子南海桂城，项目投资额2亿元，建设MOCVD装备华南总部。蓝河科技是国内目前唯一可提供全材料体系MOCVD装备的企业，致力于化合物半导体装备创新与国产化，已成功开发出五款MOCVD特色产品，覆盖第二代至第四代半导体材料，在氧化镓、砷化镓太阳能电池、特种外延领域国内领先。

原速科技是国内原子层沉积（ALD）设备领军企业和专精特新“小巨人”企业。由哈佛大学、加拿大麦吉尔大学及荷兰代尔夫特理工大学等海外名校背景创始团队领衔的原速科技，本次落户南海丹灶的“新型显示ALD研发与装备制造基地”项目，总投资5亿元，重点攻关新型显示核心装备。其ALD技术可实现“原子级”精密镀膜，是国内少数通过维信诺等头部企业产线验证的企业。安心表示，“选择南海，是看重这里庞大的制造应用市场、季华实验室等平台的技术支撑，以及南海高效贴心、精准务实的营商服务。未来将依托南海产业资源，快马加鞭推进技术落地，助力大湾区产业链补链强链。”

04 公 司 公 告

研 究 創 造 價 值

中微半导体:2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

根据中微半导体（深圳）股份有限公司2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告。

业绩预告期间；2026年1月1日至2026年6月30日。

业绩预告情况：

- 1、经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现营业收入72,600.00万元左右，同比增长44.06%左右。
- 2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润16,500.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7,853.04万元左右，同比增长90.82%左右。
- 3、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,300.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7,723.91万元左右，同比增长101.95%左右。

上年度同期业绩情况：公司上年同期营业收入为50,395.00万元，利润总额为9,057.23万元，归属于母公司所有者的净利润为8,646.96万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,576.09万元，基本每股收益为0.22元。

本期业绩变化的主要原因：本期业绩大幅增长，受益于全球AI及算力需求持续爆发，一方面挤占了MCU产能，另一方面带动了MCU需求增长，以及MCU在原有的消费电子、智能家电、工业控制、汽车电子等领域的市场需求稳步复苏，造成公司MCU市场需求增速超过公司MCU产能增速，出现产能相对紧缺状态，产品出货量增长的同时产品价格上涨，公司营收及利润实现双增长。

■ 紫光国微:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

根据紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要。

（一）本次交易方案概况
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向南昌建恩、北京广盟、天津瑞芯、建投华科等14名交易对方购买其合计持有的瑞能半导100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

交易价格（不含募集配套资金金额）：190,000.00万元

（二）标的资产评估情况：单位：万元

交易标的名称	基准日	评估方法	评估结果	本次拟交易的权益比例	交易价格
瑞能半导	2025年12月31日	市场法	190,000.00	100%	190,000.00

增值率：34.77%（母公司口径）/19.50%（合并口径）

（三）发行股份购买资产情况
股票种类：人民币普通股（A股）
每股面值：1.00元
定价基准日：上市公司第八届董事会第三十六次会议决议公告日
发行价格：61.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%；上市公司2025年度利润分配实施后除权除息，调整为61.45元/股
发行数量：24,615,377股，占发行后上市公司总股本的比例为2.82%（以上市公司截至2026年3月31日总股本计算，不考虑上市公司可转换公司债券转股情况及本次交易募集配套资金）。

晶晨股份:2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

根据晶晨半导体（上海）股份有限公司2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现营业收入439,100.00万元左右，与上年同期相比，将增加106,059.47万元左右，同比增长31.85%左右。其中，第二季度预计实现营收249,551.81万元左右，同比增长38.59%左右，环比增长31.66%左右。

2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润60,800.00万元左右，与上年同期相比，将增加11,143.04万元左右，同比增长22.44%左右。其中，第二季度预计实现归属于母公司所有者的净利润43,479.14万元左右，同比增长40.98%左右，环比增长151.02%左右。

3、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润56,000.00万元左右，与上年同期相比，将增加10,299.15万元左右，同比增长22.54%左右。其中，第二季度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润39,820.20万元左右，同比增长38.57%左右，环比增长146.11%左右。

二、上年同期业绩情况

2025年半年度营业收入：333,040.53万元。归属于母公司所有者的净利润：49,656.96万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：45,700.85万元。基本每股收益：1.18元。

澜起科技:关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书

根据澜起科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书。

截至2026年7月16日，公司A股股票收盘价格连续20个交易日内跌幅累计超过20%，达到了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第二款第（二）项规定的“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”的条件，符合《回购指引》第二条第一款第（四）项规定的“为维护公司价值及股东权益所必需”而触发回购的情形。

回购预案的主要内容：

- 回购股份金额：不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。
- 回购股份资金来源：公司自有资金。
- 回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益。
- 回购股份价格：不超过人民币332.90元/股（含）。
- 回购股份方式：以集中竞价交易方式。
- 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。根据股份登记机构的相关要求，为确保权益分派实施期间公司股本结构不发生变化，公司将从2025年年度权益分派实施完成之后启动本次回购A股股份事宜。

翱捷科技:关于2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

根据翱捷科技股份有限公司关于2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告

(一) 业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日

(二) 业绩预告情况

经翱捷科技股份有限公司财务部门对公司2026年半年度财务情况的初步测算：

- 1、预计实现营业收入约为人民币245,000.00万元，与上年同期相比，增加约55,193.36万元，同比增长约29%。
- 2、预计实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币8,500.00万元，实现扭亏为盈。与上年同期相比，增加约33,040.43万元。
- 3、预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为人民币-5,800.00万元，与上年同期相比，减亏约29,368.79万元。

(三) 上年同期业绩情况和财务状况

营业收入：189,806.64万元。

归属于母公司所有者的净利润：-24,540.43万元。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-35,168.79万元。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研创造价值